

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】令和6年11月19日(2024.11.19)

【国際公開番号】WO2023/191024

【出願番号】特願2024-512885(P2024-512885)

【国際特許分類】

B 2 2 F 1/00(2022.01)

B 2 2 F 1/12(2022.01)

B 2 2 F 1/054(2022.01)

B 2 2 F 1/068(2022.01)

B 2 2 F 1/06(2022.01)

B 2 2 F 1/07(2022.01)

B 2 2 F 9/00(2006.01)

B 2 2 F 7/08(2006.01)

10

【F I】

B 2 2 F 1/00 L

B 2 2 F 1/12

B 2 2 F 1/054

B 2 2 F 1/068

B 2 2 F 1/06

B 2 2 F 1/07

B 2 2 F 9/00 B

B 2 2 F 7/08 C

20

【手続補正書】

【提出日】令和6年9月9日(2024.9.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

30

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

Cu、Cu₂O及びCu₆4Oを含み、Cu₆4Oの含有量が、Cu、Cu₂O及びCu₆4Oの合計100質量%に対して、2.1~25.0質量%である、銅酸化物含有プレート状銅粒子。

【請求項2】

Cu₂Oの含有量が、Cu、Cu₂O及びCu₆4Oの合計100質量%に対して、5.0質量%以下である、請求項1に記載の酸化物含有プレート状銅粒子。

40

【請求項3】

窒素雰囲気下、200 で加熱したとき、加熱後にX線回折で測定されたCu(111)の結晶子径(C2)と、加熱前にX線回折で測定されたCu(111)の結晶子径(C1)との比(C2/C1)が2.0以上である、請求項1に記載の酸化物含有プレート状銅粒子。

【請求項4】

前記結晶子径(C2)が、55.0nm以上である、請求項3に記載の酸化物含有プレート状銅粒子。

【請求項5】

厚さが5~50nm、長径が30~300nmであり、かつ、前記長径が前記厚さより

50

も大きい、請求項 1 に記載の酸化物含有プレート状銅粒子。

【請求項 6】

請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の酸化物含有プレート状銅粒子を含む、ペースト組成物。

【請求項 7】

少なくとも一部が、請求項 6 に記載のペースト組成物を用いて接合されている、半導体装置。

【請求項 8】

少なくとも一部が、請求項 6 に記載のペースト組成物を用いて接合されている、電気部品。

10

【請求項 9】

少なくとも一部が、請求項 6 に記載のペースト組成物を用いて接合されている、電子部品。

20

30

40

50